

⑫ 公開特許公報 (A)

平3-160908

⑬ Int.Cl.⁵

A 01 C 1/00

識別記号

庁内整理番号

Z 8405-2B

⑭ 公開 平成3年(1991)7月10日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 発明の名称 種子の皮むき方法

⑯ 特願 平1-300567

⑰ 出願 平1(1989)11月17日

⑱ 発明者 松本 東喜雄 愛知県瀬戸市品野町3丁目145番地24

⑲ 出願人 有限会社ビジュ 愛知県春日井市篠木町6丁目1661

⑳ 代理人 弁理士 宇佐見 忠男

明細書

1. 発明の名称

種子の皮むき方法

2. 特許請求の範囲

種子を粗研磨粒と微研磨粉との混合研磨材に混合して攪拌することを特徴とする種子の皮むき方法

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は種子の皮をむく方法に関するものである。

〔従来の課題〕

種子の発芽を促進したり、あるいは種子を食用に供する際に種子の皮をむくことが必要になる。

従来では薬品処理により種子の皮を侵食除去する方法が提供されていたが、薬品が種子に付着するので食用に供する場合は問題があり、また処理時間も長くかった。そこで、種子とセラミック等の無機質からなる研磨粒とを混合して攪拌することにより種子の皮むきを行なう方法も提供され

ているが、種子の皮のみを選択的に粉碎除去することが困難で、種子自体も可成り粉碎されてしまい、歩止まりが非常に悪くなる。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、種子を粗研磨粒と微研磨粉との混合研磨材に混合して攪拌する種子の皮むき方法を提供するものである。

〔混合研磨材〕

本発明に用いられる混合研磨材は粗研磨粒と微研磨粉との混合物であり、粗研磨粒は通常径が $50\mu\sim20mm$ 程度のものを用い、微研磨粉は通常径が $20\mu\sim1700\mu$ 程度のものを用いる。そして該粗研磨粒と微研磨粉との材料は、通常例えればアルミナ、シリカ、ジルコニア、コランダム、ガラス、ケイ砂等の硬質な無機質が用いられる。そして粗研磨粒と微研磨粉との混合比は重量比で略 $10:1\sim1:10$ 程度とされる。しかしながら種子の大きさにより粗研磨粒と微研磨粉との粒径を適当に選択することが望ましく、通常種子が

大きくなると粗研磨粒と微研磨粉との粒径を大きくする。

〔種子〕

本発明の対象となる種子は、大根、白菜、サラダ菜等の野菜の種子、綠豆、大豆、小豆、落花生のような豆類、くるみ、栗等の実等である。

〔皮むき方法〕

上記種子の皮を上記混合研磨材を用いて除去するには、上記混合研磨材中に上記種子を混合し攪拌する。本発明ではこのような処理により種子の皮のみが研磨粉砕されて除去される。該処理の後、皮をむかれた種子は例えば篩別、風選等の手段により混合研磨材と分離される。

上記種子の皮むきを行なう前、あるいは皮むき中に適量の水を添加してもよい。水を添加すると種子の皮が水で膨潤してむけ易くなる。また該水には殺菌剤、成長剤等の添加剤を混合してもよい。望ましい添加剤としては二価三価鉄、焼成真珠粉等がある。水を添加する方法としては皮むき前に種子に水をスプレーする方法、種子を水に浸漬す

る方法、皮むき中に水をスプレー等で種子と研磨剤との混合物に添加する方法等がある。

〔作用〕

本発明の混合研磨材に種子を混合して攪拌すると、主に粗研磨粒により皮のみが粉砕される。この際、微研磨粉は粗研磨粒間あるいは粗研磨粒と種子との間のクッションの役割をして粗研磨粒によって種子自体まで粉砕されてしまうことを防止する。

〔発明の効果〕

したがって本発明では種子の皮を迅速に除去することが可能であり、薬品を用いないから食用に供することも出来、また微粉砕された皮が種子の周囲に付着しているから、種子は雑菌やカビから保護され、薬品処理をしたものよりも長時間の保存に耐える。

〔実施例〕

大根の種子を粗研磨粒（平均粒径1mmのアルミナ粒）と微研磨粉（平均粒径100μmのアルミナ粉）との1：2重量比混合物中に入れてゆっくり

- 3 -

- 4 -

攪拌して24時間処理する。その後皮をむかれた種子を篩別する。

このように皮をむかれた大根の種子は発芽させてかいわれ大根にすると、食用に際して種子の皮がないので口あたりが極めて良好になる。

特許出願人 有限会社 ビジュ
代理人 宇佐見忠男

